

초고진공 전자공명 화학기상증착법을 이용한

$\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 박막의 저온에피성장

(Low-temperature heteroepitaxial growth of $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$
using Ultrahigh Vacuum - Electron Cyclotron Resonance
Chemical Vapor Deposition)

주성재*, 황석희*, 황기현, 윤의준, 황기웅*

서울대학교 무기재료공학과

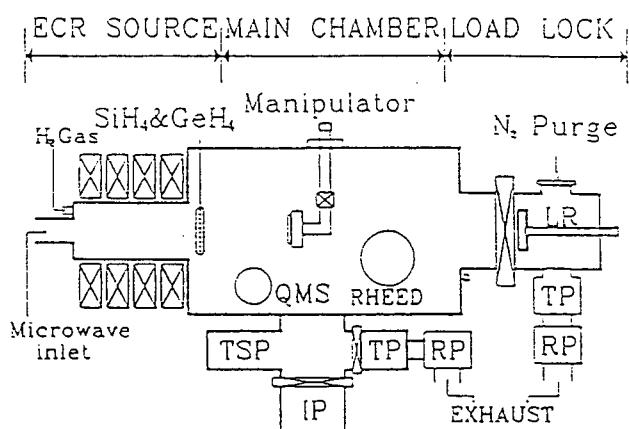
*서울대학교 전기공학과

$\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ (이하 SiGe)는 Si과 Ge이 원자수준에서 균일하게 섞여있는 고용체(solid solution)를 일컫는다. $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 저온에피성장기술을 확보하면 기존의 Si 반도체 제조공정에 접목할 수 있으면서, Si으로 만든 소자에 비해 뛰어난 성능을 갖는 소자를 제조할 수 있으므로 최근 초미의 관심이 되고 있다(1).

본 실험에서는 기초진공도를 약 1×10^{-9} torr로 유지할 수 있는 초고진공 화학기상증착장치에서 ECR 수소플라즈마를 사용하여 SiGe 저온에피성장을 수행하였다(그림 1). 반응기에 유입되는 기체로는 H_2 , SiH_4 , GeH_4 를 사용하였으며, 성장온도는 440°C , 성장압력은 3 - 4 mTorr였다. 기판에 가해주는 DC bias, 전자석에 가해주는 bobbin 전류, 마이크로파 전력 등은 각각 이전에 수행된 무전위(dislocation - free) 저온 Si에피성장의 최적조건인 $+100\text{V}$, 40A , 50W 로 유지하였다(2). 성장이 끝난 직후 반응기에 장착된 in - situ RHEED로 박막의 결정성을 확인하였으며, TEM관찰로 박막의 결정성 확인 및 결함생성여부를 관찰하였다. 박막의 두께와 조성은 RBS로 측정하였다.

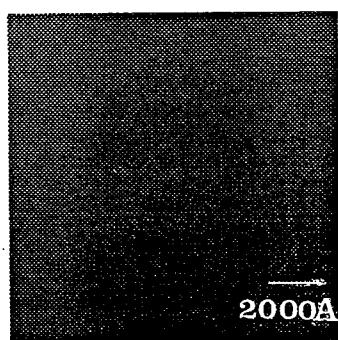
Ge함량 25% 이하인 박막을 TEM으로 관찰한 결과 Matthews - Blakeslee의 mechanical equilibrium theory에 의한 임계두께(critical thickness)(3)보다 두꺼워도 격자이완(misfit relaxation)이 일어나지 않은 무전위 박막을 얻었음을 확인하였다(그림 2). 그러나 DC bias를 낮추거나, 마이크로파 전력 또는 bobbin 전류를 증가시켜서 기판에 입사되는 ion의 flux/energy를 증가시키면 박막에 결함이 생성되었으며 격자이완이 촉진됨을 관찰하였다. 한편 440°C , $+100\text{V}$, 50W , 40A 에서 GeH_4 유량을 증가시켜서 박막의 Ge함량을 증가시키면서 성장속도를 측정한 결과 Ge함량이 증가함에 따라 성장속도가 증가하는 현상을 관찰하였다(그림 3). 이러한 경향은 저온 thermal UHVCVD에서의 결과와 유사하며(4), ECR 플라즈마를 사용한 본 실험에서도 수소탈착이 속도결정단계라는 것을 보여준다.

본 연구는 아직 진행중에 있으며, 앞으로의 실험은 플라즈마 변수를 변화시켜 기판에 입사되는 ion의 flux/energy를 증가시켰을 때의 Ge함량증가에 따른 성장속도의 변화양상 및 격자이완 촉진여부를 중점적으로 연구할 계획이다.

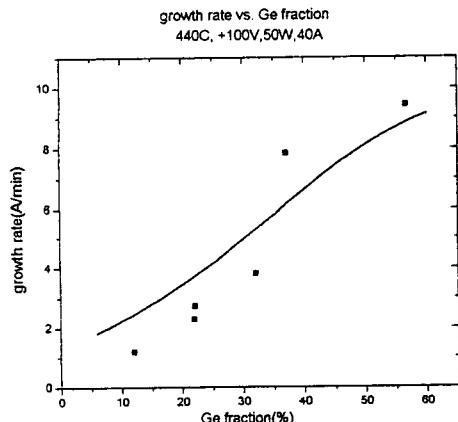


IP: Ion Pump LR: Loading Rod
 RP: Rotary Pump
 TP: Turbomolecular Pump
 TSP: Titanium Sublimation Pump

<그림 1> UHV - ECRCVD 장비의 개략도



<그림 2> plan - view TEM 사진



<그림 3> Ge함량에 따른 성장속도의 변화

* 참고 문헌 *

- 1) B. S. Meyerson, "UHVCVD growth of Si and SiGe alloys", Proc. IEEE, 80, 1592(1992)
- 2) H. S. Tae, S. H. Hwang, S. J. Park, E. J. Yoon, and K. W. Hwang, "Low - temperature silicon epitaxy by ultrahigh vacuum electron cyclotron resonance chemical vapor deposition", Appl. Phys. Lett., 64, 1021(1994)
- 3) J. W. Matthews, S. Mader, and T. B. Light, "Accommodation of misfit across the interface between crystals of semiconducting elements or compounds", J. Appl. Phys., 41, 3800(1970)
- 4) B. S. Meyerson, K. J. Uram, and F. K. LeGoues, "Cooperative growth phenomena in silicon/germanium low - temperature epitaxy", Appl. Phys. Lett., 53, 2555(1988)